

ROYAPOX 5050 CD ENDURECEDOR 5050

RESINA EPOXY

CLASE TÉRMICA: B (130°C)

POLIMERIZACIÓN AL AIRE

- ✓ Buenas propiedades dieléctricas
- ✓ Buenas propiedades mecánicas
- ✓ Resistencia a la humedad

CAMPO DE APLICACIÓN

Resina bicomponente puede utilizarse en el encapsulado ó relleno de componentes eléctricos y electrónicos, que requieran una protección contra la humedad y contra los cambios de temperatura.

MODO DE EMPLEO

Recomendamos precalentar a 50°C y agitar la resina, antes de ser mezclada con el endurecedor a relación 100/20, de esta forma se evitara los efectos de la carga sedimentada en el fondo de los botes y se obtendrá una mejor viscosidad en la colada. El empleo de máquinas mezcladoras-dosificadoras automáticas, favorece la manipulación de este producto. Si se desea desencapsular la resina polimerizada, se deberá aplicar nuestro agente desmoldeante en el molde. Para piezas encapsuladas que deban presentar máximas características eléctricas recomendamos realizar la colada bajo vacío. El tiempo de vida de los dos componentes separados siempre que esten en su recipiente original y precintados es de un año.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

	ROYAPOX 5050 CD	ENDURECEDOR 5050	MEZCLA 100/20
Viscosidad a 25°C (mPa.s)	10000 ± 2000	30 ± 10	1200 ± 200
Densidad a 20°C (g/cm ³)	1.65 ± 0.05	0.99 ± 0.02	1.55 ± 0.02
Pot Life a 25°C (min)	60		
Polimerización total	3h. a 100°C		
Dureza Shore D	83		
Resistencia a la tracción (MPa)	75		
Alargamiento a la rotura (%)	3.5		
Absorción agua 24h, 20°C (% peso)	0.13		
Rigidez dieléctrica, 50Hz, 20°C (KV/mm)	15		
Resistencia superficial (Ohm)	1 .10 ¹²		
Resistencia específica (Ohm.cm)	1 .10 ¹⁵		
Factor de disipación tg, 50Hz, 20°C	0.003		
Constante dieléctrica, 50Hz, 20°C	3.6		
Resis. defor. térmica Pto. Martens (°C)	70		
Conductividad térmica (W/mK)	0.5-0.6		

FORMA DE SUMINISTRO

En envases metálicos con capacidad de 1, 5, 25 Kg, con la dosificación separada de su endurecedor correspondiente.

Rev. Octubre 2019

Versión: 2

La información que les ofrecemos es de carácter informativo y como resultado de nuestros ensayos, pero sin asumir ninguna responsabilidad derivada de su aplicación.